

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

申请获得上海证券交易所受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）[2021]6 号）。上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 5 日